

新成長戦略 Phase I（2024~2026年度）進捗報告

ウシオ電機株式会社
2025年5月13日

Copyright © 2025 Ushio Inc., All Rights Reserved

*本資料の記載は、切捨てによる億円単位で表記しております。

*売上高は外部顧客向け。営業利益率は、外部顧客向け売上高に対する比率を記載しております。

*本資料内では、以下の略称を使用しています：

IP=Industrial Process事業、VI=Visual Imaging事業、LS=Life Science事業、PHS=Photonics Solution事業



新成長戦略を公表して1年が経過しましたが、その進捗及び今後の目標達成に向けた方向性について、改めてご説明させていただきます。

なお、今からご説明します2026年度を含めた将来見通しは、現時点で入手可能な情報をもとに予想しています。米国の関税措置影響などによる足元の動向変化は、一部の確認できたものを除き、その影響の見積もりが困難なため予想に織り込んでおりません。

経営方針及び係数目標に変更なし

方針 経営効率を重要視した成長戦略

成長・開発投資、リソースを
IP事業に集中
成長拡大



“率”を追求



成長投資と資本効率
を両立

1年目 (FY24)
進捗

事業の取捨選択を進め
IP事業へリソース転換を実施

事業の取捨選択を実施
収益改善が進み
一定の成果を実現

成長投資：156億円、
自社株投資+配当：342億円を実施
(自己資本比率 FY23末：70%
→FY24末：67%)

係数目標

Phase I
(~FY26)

ROE **8**%以上

(早期にPBR1倍超を達成)

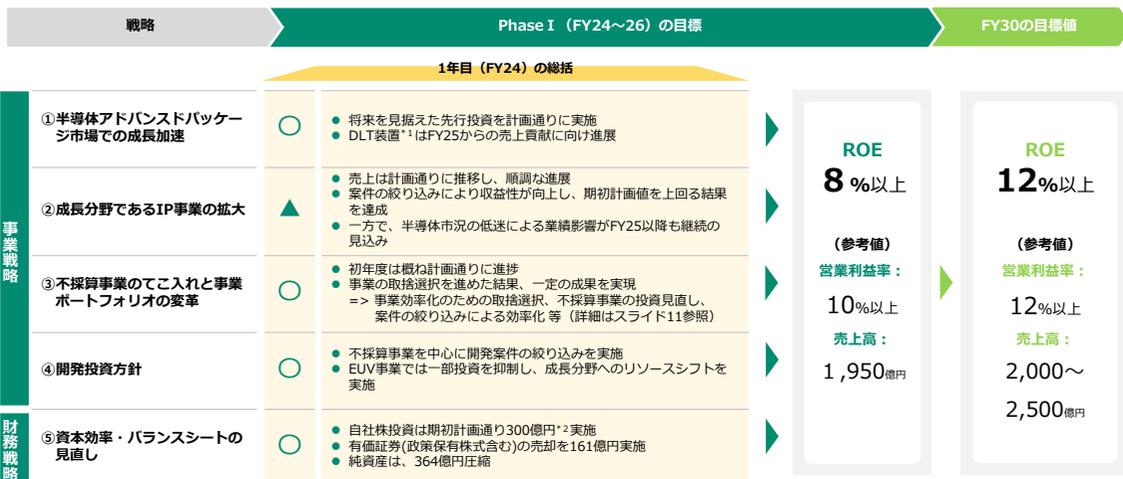
Phase II
(~FY30)

ROE **12**%以上

参考：営業利益率 **12**%以上

1年前に大きく3つの方針を掲げ新成長戦略をスタートさせ、各方針の取り組みを順調に進めており、現時点で2026年度のPhase I及び2030年度のPhase IIの係数目標及び方針に変更はございません。

半導体市況低迷の影響長期化が業績に影響も、事業ポートフォリオ変革などの各施策については着実に進展



*1 DLT装置：アプライドマテリアルズ社との業務提携によるDLT(デジタルリソグラフィ技術)搭載の露光装置のこと。以降のページ同様
*2 2025年4月4日取得分まで含む

「事業戦略」及び「財務戦略」の各施策については、概ね計画通りに進めることができました。ただし、インダストリアルプロセス事業については、半導体市況の低迷が長期化しており、2025年度以降も影響が長引く見込みから、引き続き、注視が必要です。

次ページより、各施策の具体的な進捗及び今後の方向性をご説明します。

①半導体アドバンスドパッケージ市場での成長加速

目指す
方向性

- **生成AI半導体市場への貢献と成長拡大**
生成AI半導体の拡大に向け、適切なタイミングで製品を投入し、成長を加速
- **中核事業として体制強化と収益最大化**
将来の中核事業として運営体制を強化し、収益の最大化を目指す

進捗

進捗&戦略
(FY25~FY26)

戦略

- ◆ 足元で不透明な市況環境を受け一部案件で遅延発生も、**初受注を獲得。FY25からの売上計上に向け、随時、受注が確定の見込み**
- ◆ 販売開始に向け、生産準備を進行中
- ◆ DLT技術に対する関心は高く、今後の採用に向けた顧客の認証プロセスが進展中
- ◆ **生産・販売体制の構築と遂行**
生産・販売体制を着実に構築し、計画通り販売を開始
- ◆ **製品ラインアップの拡充**
半導体最先端パッケージ技術のトレンド変化を的確に捉え、着実な採用実現に向け製品のフルラインアップ化を推進
- ◆ **顧客ニーズに応える製品開発**
半導体インターポーザ基板のパネル化等の進化に対応し、歩留り向上、製造コスト低減など顧客ニーズに応える製品を投入

半導体アドバンスドパッケージ市場



半導体アドバンスドパッケージ関連装置の売上高推移



「半導体アドバンスドパッケージ市場の成長加速」ですが、同市場向けの新製品となるデジタルリソグラフィ装置において、足元で不透明な市況環境を受け、一部案件で遅延が発生していますが、既に初受注を獲得しており、今期2025年度後半より立ち上がります。

引き続き、多くのお客様で評価が継続しており、順次、採用に向けた認証が進む見込みです。

①半導体アドバンスドパッケージ市場での成長加速

補足：最先端ICパッケージ基板（主に、ステッパ及びDI露光装置関連）

事業環境
前提

FY25

- 従来型サーバー及びPC需要が2022年以降に急減速したことで、最先端ICパッケージ基板全体での過剰キャパシティ状態が継続



FY26

- 生成AIの需要拡大が継続並びに従来型サーバー及びPC需要が徐々に回復
- 過剰キャパシティ状態が徐々に解消し、露光装置の先送り案件が動き始める見込み
- 生成AIなどの新たな需要で採用が拡大する見込み（課題の主要顧客の依存度の高さは解消の見込み）

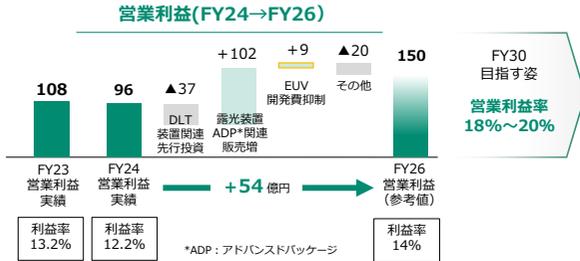
DLT装置については、Appendixにて追加説明あり [スライド28～30参照](#)

なお、2026年度は、需要が低迷している最先端ICパッケージ基板市場において、過剰キャパシティの解消が徐々に進むと見ており、デジタルリソグラフィ装置の販売拡大に加え、ステッパやDIなどの既存の露光装置も増加に転じる見込みです。

デジタルリソグラフィ装置については、後ほど補足説明をいたします。

②成長分野であるIP事業の拡大

リソースを集中し、着実な成長を成し遂げる



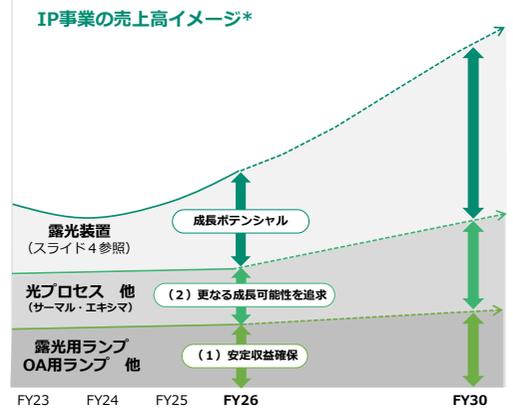
1年目の進捗

- ✓ 半導体市場の回復は遅延し、想定を下回り推移
- ✓ 半導体アドバンスドパッケージ事業の準備は順調
- ✓ EUV事業関連の開発投資の一部を抑制

今後の方向性

以下3つのカテゴリで戦略を実施し成長拡大

- ✓ 安定収益確保_(1) [スライド7参照](#)
- ✓ 更なる成長可能性を追求_(2) [スライド8参照](#)
- ✓ 成長ポテンシャル [スライド4参照](#)



* FY24までは実績、FY25は計画、FY26は参考値

「成長分野であるIP事業の拡大」ですが、今、ご説明した半導体アドバンスドパッケージ事業を中心に、成長拡大を計画しています。

大きく成長する露光装置に加え、光プロセスなどの半導体関連製品において更なる成長可能性を追求。また、露光用ランプを中心に安定した収益を確保し続けることで、着実にインダストリアルプロセス事業を成長させていく計画です。

光プロセスや露光用ランプの目指す方向性や戦略については、スライド7及び8ページに掲載していますので、後ほど、ご覧ください。

(スライド9ページへ)

②成長分野であるIP事業の拡大

露光用ランプ

USHIO

(1) 安定収益確保

目指す
方向性

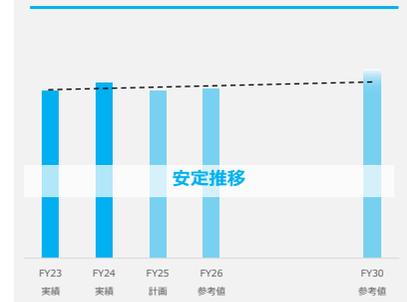
- **付加価値の高い製品・サービスによる収益最大化**
トップシェアメーカーとして、付加価値の高い製品・サービスを提供し、更なる収益の最大化を目指す
- **生産性向上とコストダウンによる安定的な収益確保**
生産性向上とコスト削減で安定した収益を確保し、成長分野への投資を推進

戦略

(FY25~FY26)

- ◆ **運営コストの見直しによる安定的な収益確保**
原材料費や人件費の高騰に対応し、運営コストを見直すことで、コスト抑制を実施。安定した収益の確保を目指す
- ◆ **半導体 i 線露光装置の新設投資と需要の取り込み**
ブランド力や品質、サービス力を活かし、新規採用案件やリプレイス需要を着実に取り込み、事業基盤を強化
- ◆ **他社との協業・連携およびM&Aによる市場シェアの拡大**
協業やM&Aを通じて市場シェアを拡大し、競争力を強化

露光用ランプ 売上高推移見込み



②成長分野であるIP事業の拡大

光プロセス（サーマル・エキシマ）他

USHIO

(2) 更なる成長可能性を追求

目指す
方向性

- **成熟市場と成長分野のバランス戦略**
LCD向け案件を絞りつつ、成長拡大が見込める半導体分野への投資を進め、事業拡大を目指す
- **サーマル事業の成長**
高い制御性を持つ熱処理技術を活かし、半導体の微細化に伴う熱処理ニーズを取り込む
- **エキシマ事業の注力領域転換**
FPD市場依存から脱却し、成長が期待される半導体分野に注力
- **新たな領域への展開**
半導体を中心とした検査装置市場への展開を推進

戦略

(FY25~FY26)

サーマル事業

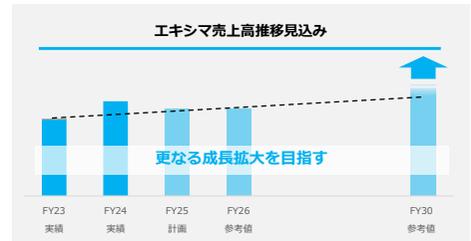
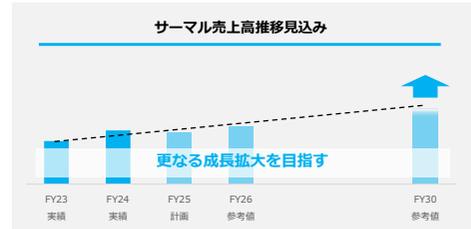
- ◆ 主要顧客への組み込み採用率を高め、収益基盤を強化
- ◆ パートナー企業との関係を深め、事業の安定性を向上

エキシマ事業

- ◆ 半導体分野へ注力することで安定収益を確保
- ◆ 光源特性を活かし、建材、車両、電池市場など新たな分野への展開を推進し、事業拡大を目指す

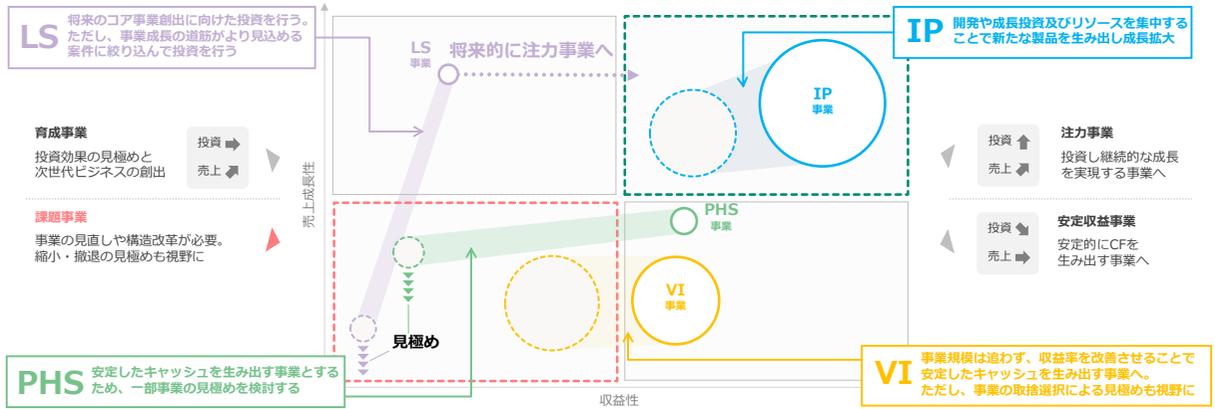
新たな市場展開（検査装置市場）

- ◆ 半導体先端ロジック向けを中心に検査装置市場への展開を図る



③不採算事業のてこ入れと事業ポートフォリオの変革（再掲）

○…現在 ○…2030年の目指す姿

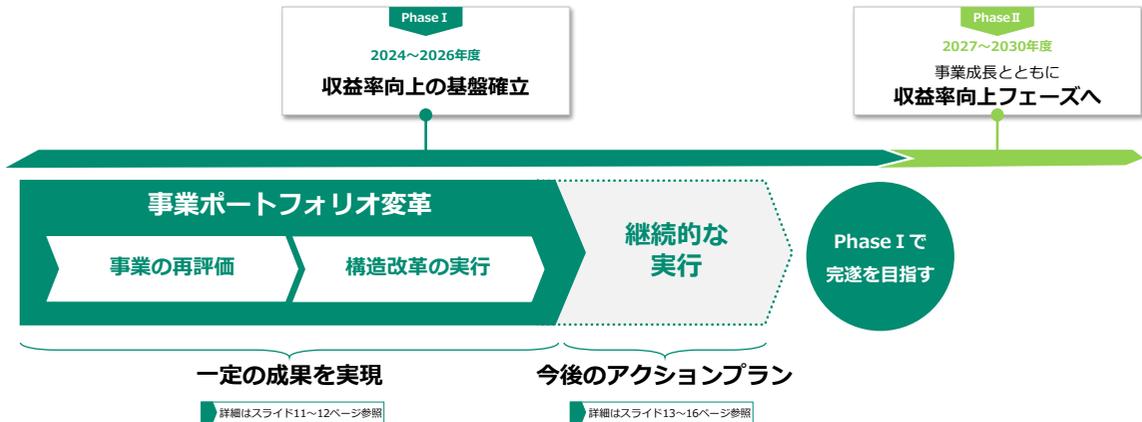


「不採算事業のてこ入れと事業ポートフォリオ変革」については、以前にお示した各セグメントの目指す方向性に向け、取り組みを進めています。

③不採算事業のてこ入れと事業ポートフォリオの変革

【事業ポートフォリオ変革の全体像】

構造改革は、実行フェーズに入りFY24で一定の成果を実現も、Phase I で完遂させるべく抜本的な収益構造改革を継続



「事業ポートフォリオ変革」の進捗ですが、1年目は一定の成果を実現できました。

2年目となる2025年度以降も継続的に取り組み、Phase I の最終年度である2026年度での完遂を目指します。

③不採算事業のてこ入れと事業ポートフォリオの変革

FY24：事業ポートフォリオ変革に伴う「成果」が具現化も、将来の成長を見据えた「一時コスト」発生

	内訳	成果額
成果 +31億円	・ 事業効率化のための取捨選択	VI事業 +11億円
	・ 不採算事業の投資見直し	LS・PHS事業 +6億円
	・ 案件の絞り込みによる効率化	新規事業、EUV事業 等 +14億円
	内訳	発生コスト
一時コスト ▲37億円	・ 財務健全性の強化 将来の収益性向上に向け棚卸資産の評価を厳格に見直し	VI事業の製品及び保守部品 ▲32億円
	・ リソース再配分による資産整理 将来の成長性が見込めない案件を厳格に評価することで関連する資産を整理	IP・LS・PHS事業 ▲5億円

各セグメントにおいて事業の取捨選択を進めた結果、1年目の成果として、31億円の収益改善を行うことができました。一方で、一時的なコストも発生しました。

③不採算事業のてこ入れと事業ポートフォリオの変革

FY24：構造改革による収益性改善が進展 FY25以降：継続的に収益性改善の取り組みを推進

	FY24実績（成果）	FY25以降の方向性
Industrial Process事業	<ul style="list-style-type: none"> ● EUV事業： <ul style="list-style-type: none"> ・市場及び技術動向を精査し一部開発案件を中止 ・成長分野への人的リソースシフト実施 	<ul style="list-style-type: none"> ● EUV事業： <ul style="list-style-type: none"> ・投資を抑制し、適正リソースへの見直を継続 ・要素技術開発を継続し、将来性ある案件を検証
Visual Imaging事業	<ul style="list-style-type: none"> ● 競争優位性及び収益性の高いハイエンド領域へ集中（製品ポートフォリオの見直しを実施） 	<ul style="list-style-type: none"> ● ハイエンド領域への更なる集中 ● 収益性向上に向けた構造改革の諸施策を実行
Life Science事業	<ul style="list-style-type: none"> ● 将来の事業性が見込めない新規事業案件を厳格に再評価し絞り込みを実施。半数以上の案件を収束 主な収束案件:大豆育成、円筒型太陽電池、メタン処理など 	<ul style="list-style-type: none"> ● 継続案件のモニタリングを強化
Photonics Solution事業	<ul style="list-style-type: none"> ● 投資案件の精査を行い一部開発案件を中止 ● 人的リソースの見直し(再配置) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 収益性改善の諸施策を実行 ● あらゆる選択肢をもって事業運営の見直しを継続検討

FY25以降の具体的な構造改革アクションプランは次ページ以降に記載

Copyright © 2025 Ushio Inc., All Rights Reserved 12

各セグメントで行った「事業の取捨選択」は、主に開発案件を中心に徹底した事業評価による絞り込みを行いました。これらの取り組みは2025年度以降も継続します。

2025年度以降の具体的なアクションプランは次ページ以降でご説明します。

③不採算事業のてこ入れと事業ポートフォリオの変革

FY25～FY26：構造改革アクションプランの全体像

FY26の経営目標達成と将来の成長基盤への回帰を目指し、収益構造の改善を最優先課題として改革に取り組む

- 2025年度は、収益構造改善の実行フェーズと捉え、最優先に施策を実施
- これらの成果として、FY25～FY26：73億円以上の固定費削減を実現し、収益改善を目指す

	主な施策	固定費削減額*	参照ページ	
今後の 収益改善策	課題事業 収益改善策	Industrial Process事業		
		◆ EUV開発投資の抑制	9億円	スライド6、18参照
		Visual Imaging事業		
		◆ 拠点の統廃合や縮小及び組織運営の見直し	34億円	スライド14参照
全社での 取り組み		Photonics Solution事業		
		◆ 開発案件の見直し	4億円	スライド15参照
		Life Science事業		
		◆ 案件のモニタリング強化とリソース適正化	4億円	スライド16参照
		◆ セカンドライフ支援制度拡充による固定費削減	22億円	スライド25参照
		◆ 事業成長促進のため経営体制を再編	-	スライド17参照

*固定費削減額は、FY24に対するFY26の効果額

Copyright © 2025 Ushio Inc., All Rights Reserved 13

Phase I 最終年度の2026年度までの2年間の収益構造改善に向けた具体的な「構造改革アクションプラン」を、このページにまとめています。

記載の通り、各セグメントで取り組みを進めることで、トータルで73億円以上の固定費削減を目指します。

詳しくは、各参照先のスライドに記載していますが、主要なセグメントでの取り組みのみ、ご説明します。

③不採算事業のてこ入れと事業ポートフォリオの変革

Visual Imaging事業

目指す方向性

- **収益構造の抜本的な改善による事業体質の変革**
低利益体質から脱却し、抜本的な収益構造の改善を通じて、グループ全体の利益に貢献する事業体へと変革させる
- **高付加価値製品・サービスへの集中による収益性向上**
高付加価値な製品やサービスに注力し、業界内での優位性を維持しながら収益性を改善
- **事業の最適な方向性*を見極め、あらゆる可能性を慎重に検討** *目録：WACCを見据えた評価

今後の収益改善策 (FY25~FY26)

- 高付加価値及び競争優位性の高いハイエンド領域に集約することで収益性を向上
- 在庫・物流の最適化や拠点の見直しで固定費を抜本的に見直し（複数拠点を廃止）

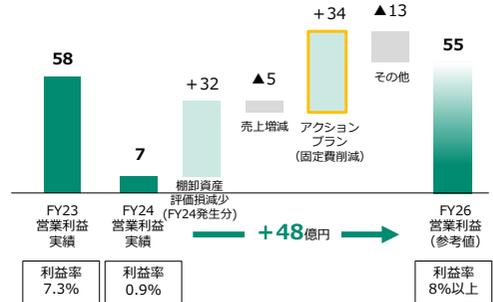
固定費削減のアクションプラン

1. 拠点の統廃合
2. 組織運営の見直し

収益改善額

34億円

営業利益(FY24→FY26)



利益率 7.3%

利益率 0.9%

利益率 8%以上

ビジュアルイメージング事業ですが、複数拠点の統廃合や組織運営の見直しなどを通じ、34億円の固定費削減を行うことで、収益構造の抜本的な改善を目指します。

並行して、事業評価を厳格に行い、事業の最適な方向性を見極め、あらゆる可能性を慎重に検討していきます。

③不採算事業のてこ入れと事業ポートフォリオの変革

Photonics Solution事業

目指す方向性

- **収益性の抜本的な改善**
事業運営体制を抜本的に見直し、収益性の改善に取り組む
- **事業の最適な方向性*を見極め、あらゆる可能性を慎重に検討**
*目線：WACCを見据えた評価

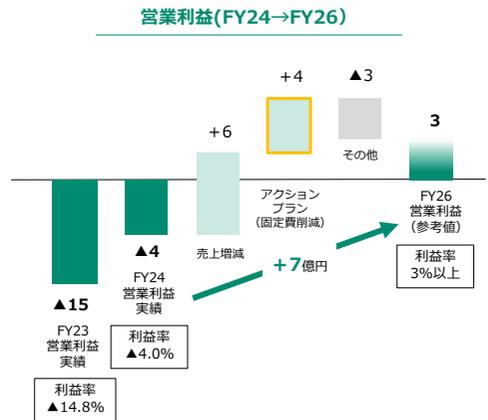
今後の収益改善策 (FY25~FY26)

- 赤字脱却を最優先に、投資を絞り込み付加価値の高いプロジェクトに集中
- 事業運営体制を抜本的に見直し、収益構造を改善

固定費削減のアクションプラン

開発案件の見直し **4 億円**

収益改善額



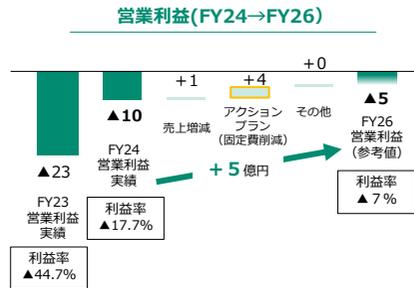
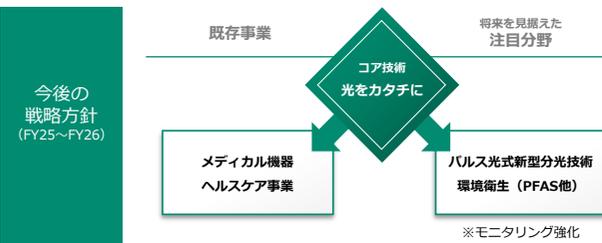
フォトニクスソリューション事業についても、事業運営体制の抜本的な見直しや開発案件の抑制などを通じ、収益性を改善させ、黒字化を目指します。

また、ビジュアルイメージング事業同様に、事業評価を厳格に行い、引き続き、事業の方向性のあらゆる可能性を慎重に検討していきます。

③不採算事業のてこ入れと事業ポートフォリオの変革

Life Science事業

- 目指す方向性**
 - 将来の持続的な企業価値向上を目指し、新たな事業創出を通じて「光」の技術で社会課題の解決に貢献
 - 新規事業案件は厳選しモニタリングを強化することで実現可能性を高め、将来の持続的な成長及び業績に寄与
- 今後の収益改善策 (FY25~FY26)**
 - 既存事業の維持・成長を通じて安定した収益を確保
 - 新規事業は、高い収益性と市場性のある案件に厳選し、早期事業化を目指す
 - リソースを適正化し、固定費抑制を継続



ライフサイエンス事業については、将来の企業価値向上に資する新規事業創出の取り組みを進めます。
 ただし、これまで以上にモニタリングを強化し、厳格に事業評価を行うことで、より実現可能性の高い案件を厳選し取り組みを進めていきます。

各施策の実行性を高める経営体制(組織)の再編

事業ポートフォリオ変革の実行性を高め、事業成長を着実になし遂げる事業運営を推進するため、一部の経営体制(組織)を再編

事業運営機能の強化

- ◆ **半導体アドバンスドパッケージ事業の推進体制強化**
コア事業化を目指し、推進体制を強化するとともに、グループ内の連携を拡充
- ◆ **光プロセス事業部のポートフォリオ見直し**
事業ポートフォリオを見直し、収益性の改善と事業化の加速を図る体制を構築
- ◆ **コア技術を支える新規技術基盤の強化**
技術本部を新設し、技術開発とマーケティングを強化することで、新規事業創出を推進
- ◆ **半導体製造プロセスのマーケティング統括部門の新設**
技術戦略と連携したマーケティング統括部門を新設し、事業再編を推進

本社機能の強化

- ◆ **生産本部の組織統廃合とリソース最適化**
生産本部で組織統廃合とリソースの最適化を進め、生産性の改善と最大化を図る体制を構築
- ◆ **経営管理部門の再編による効率化とガバナンス強化**
本社部門で経営管理部門を再編し、経営効率の向上とガバナンス強化を推進する体制を整備

ここまでご説明してきた事業戦略の実行性を高めるために、一部、経営体制の見直しを行いました。

特に、半導体アドバンスドパッケージ事業を着実に進めるべく、体制を強化しました。

④開発投資方針

将来の成長拡大が見込まれる投資は計画通り実施。将来性が見込めないものは抑制。引き続き、案件のモニタリングを強化

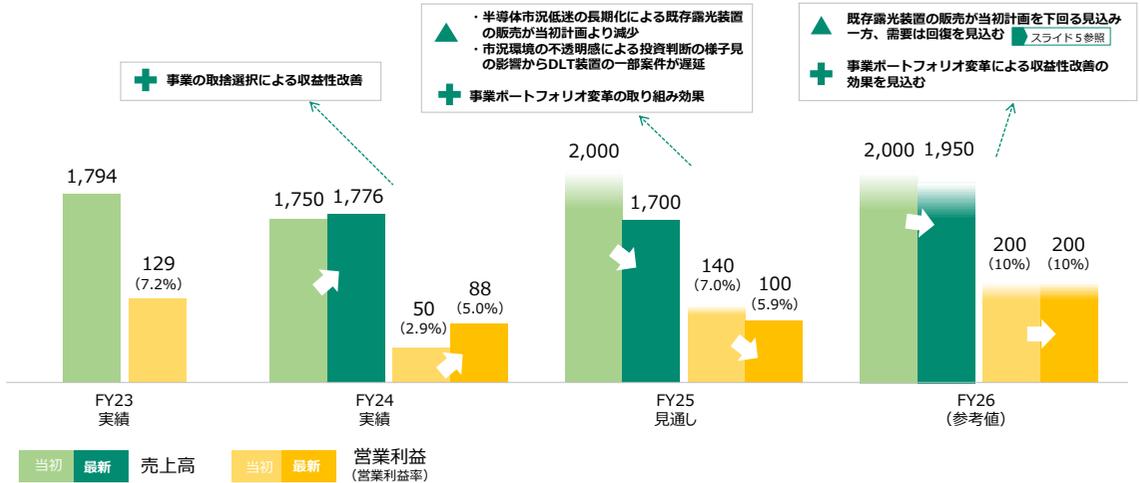
単位：億円	累積開発投資 (FY24-26) 見直し後	開発投資 内訳				
		累積 (FY24-26)			見直し内容と今後の方向性	
		今回	前回差異	前回		
			下線部分のみ見直し			
IP Industrial Process	220	露光装置	約150	—	約150億円	• 将来の成長が見込まれる次世代露光装置の開発は計画通り継続
		EUV	約30	▲30	約60億円	• 投資を抑制。FY25以降、開発投資は減額 • 要素技術開発のみ継続し、可能性ある案件の検証のみ継続
		その他	約40	▲30	約70億円	• 更なる成長可能性ある光プロセス（サーマル・エキシマ）や 半導体検査光源などに投資を集中 • その他、将来性が見込めない案件は抑制
VI Visual Imaging	100	映像装置	約100	▲20	約120億円	• 開発案件をハイエンド機種に集中すべく絞り込みを実施 (注) 前回数値を見直し（約75億円→約120億円）
LS Life Science	60	—	約60	▲25	約85億円	• 新規事業創出案件の絞り込みを実施し抑制。モニタリング強化
PHS Photonics Solution	25	—	約25	▲10	約35億円	• 投資案件の見直しによる抑制（一部案件中止）
合計	405			▲115	520億円	

Copyright © 2025 Ushio Inc., All Rights Reserved 18

「開発投資方針」ですが、事業の選択と集中を進めたことで、開発案件の絞り込みを行い、Phase I の3年間累計で115億円の開発投資を見直しました。

まとめ

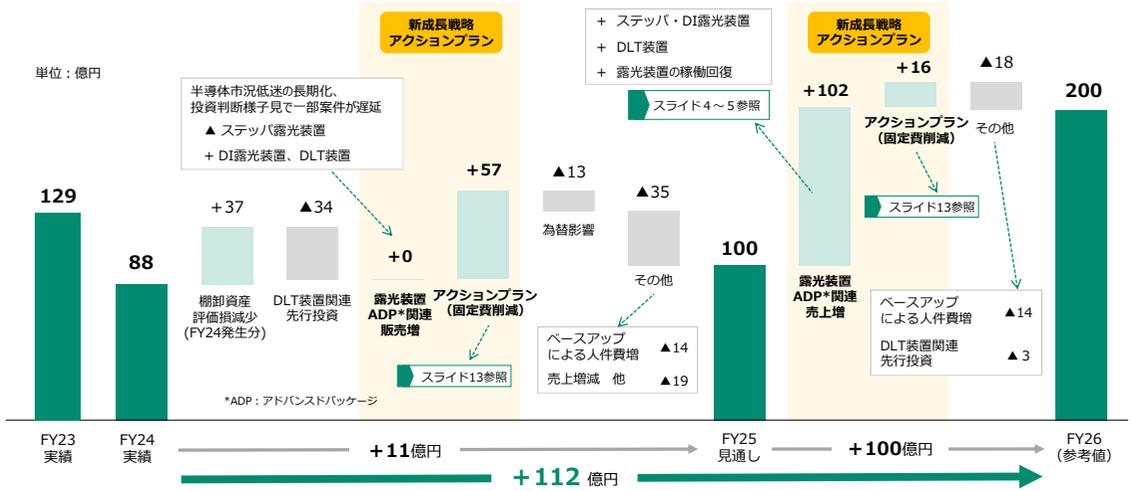
前回からの変更点：既存の露光装置が当初計画を下回り推移する予定も、事業ポートフォリオ変革の取り組みが進み、当初計画以上の効果（収益性が改善）により、FY26の営業利益・営業利益率（参考値）は維持



ここまでご説明した事業戦略についてまとめますと、足元で、半導体市況の低迷や関税動向等による市況環境の不透明感による影響があるものの、事業ポートフォリオ変革の方針に則り構造改革の各施策を実行することで、収益改善が進む計画です。

参考値ではありますが、2026年度の係数目標達成に向けて着実に進めています。

営業利益 200億円達成の道筋 (FY24→FY26)



2024年度は営業利益88億円の結果でしたが、2026年度の経営目標であるROE 8%以上達成に向け、半導体アドバンスドパッケージ事業の成長拡大と構造改革アクションプランの実行を中心に目標達成に向けて進めます。

以上が、事業戦略の説明です。

⑤ 資本効率・バランスシートの見直し

財務戦略に関わる主要係数目標（FY23→FY26目標） 各指標のFY26目指す方向性に変更なし

収益体質の強化	FY23	FY24		FY26	備考
ROE	4.5%	3.1%	→	8%以上	株主資本コスト：7%程度
営業利益率	7.2%	5.0%	→	10%以上	FY25：5.9%
バランスシートの強化（資産効率改善）					
自己資本	2,369億円	2,005億円	→	1,800億円～1,900億円	
政策保有株式簿価 (対純資産時価ベース)	68.4億 (7.9%)	47.0億円 (5.3%)	→	縮減	
資本構成の改善					
1株当たり配当金	50円	70円 (20円増配)	→	70円	
自社株投資	300億円	300億円*	→	FY25～FY26 200～300億円	

* 2025年4月4日取得分まで含む

Copyright © 2025 Ushio Inc., All Rights Reserved 21

続いて財務戦略ですが、2024年度の各施策は計画通り進めました。また、2026年度の目指す方向性について変更はありません。

⑤資本効率・バランスシートの見直し

FY24は、政策保有株式含む有価証券の縮減を加速（縮減額：▲161億円*1を実行） 引き続き、縮減を進める

*1 キャッシュフローベース

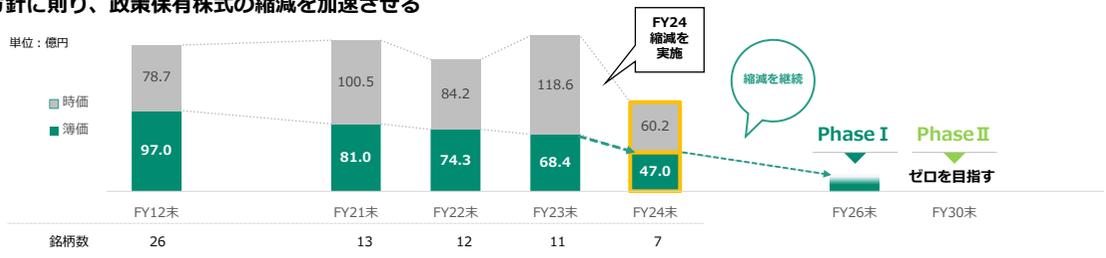
有価証券*2売却予定スケジュール（キャッシュフローベース）



*2 政策保有株式、長期債券及び純投資株式

政策保有株式縮減方針

方針に則り、政策保有株式の縮減を加速させる



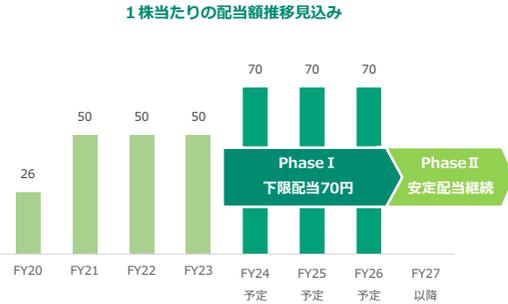
政策保有株式を含めた有価証券については、Phase I で約350億円の売却を進め縮減する計画ですが、1年目となる2024年度で161億円の売却を実施しました。引き続き、縮減を進めてまいります。

⑤資本効率・バランスシートの見直し

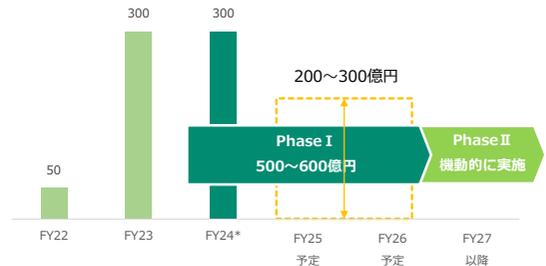
FY24は、計画通り自社株投資300億円実施。

Phase Iの残り2年も計画通り自社株投資200~300億円を実施予定。下限配当70円は継続実施

配当方針 (単位:円)



自社株投資 (単位:億円)



* 2025年4月4日取得分まで含む

株主還元については、2024年度は計画通り実施しました。
2025年度も方針に則り、1株当たりの配当額は下限配当70円を継続。

また、自社株投資についても設定した枠を計画通り実施する方針で2025年、2026年度の2年間で200~300億円の実施を予定しています。

その他の各指標については、Appendixに記載していますので、後ほど、ご覧ください。

エンゲージメント向上に向けた施策の進捗

年度計画に基づき着実な活動を実施。エンゲージメントスコアの更なる向上による企業価値向上を目指す

	FY2024活動計画	実績	業績への貢献期待
内部エンゲージメント	①発信 <ul style="list-style-type: none"> ESGの理解度促進に向けた発信強化 自業務とマテリアリティの連動意識付け 	<ul style="list-style-type: none"> 経営層による戦略や事業との結びつき訴求の社内向け動画の自社制作と配信 	社員エンゲージメントスコア向上による営業利益率向上の相関効果
	②施策展開 <ul style="list-style-type: none"> ESGを理解・体感できる施策展開 	<ul style="list-style-type: none"> 社内向けESGメルマガ配信 対話会の企画及び運営 	
	③エンゲージメントサーベイの継続実施 <ul style="list-style-type: none"> 定点観測 	<ul style="list-style-type: none"> 対象拠点を拡大し実施 →スコア61%*(前年度比+5pt) *採用エンジンでの日本の製造業平均：60% 	
	④エンゲージメントスコア分析及び提言 <ul style="list-style-type: none"> 施策の効果検証、優位点、課題の共有 	<ul style="list-style-type: none"> 独自分析結果のフィードバック会を実施 	
外部エンゲージメント	①主要外部評価分析力向上 <ul style="list-style-type: none"> メソドロジー解析の対象拡大 	<ul style="list-style-type: none"> メソドロジー解析の対象拡大 メソドロジーに基づく開示内容の充実 →スコア・・・FTSE：4.1、MSCI：AA 	①外部評価とPBRの相関効果 (ESG推進本部独自調べ) ②ESG投資INDEX選定 (投資呼込) ③法規制対応による業績へのマイナスインパクトの回避
	②非財務情報開示義務化への対応 <ul style="list-style-type: none"> 非財務情報開示義務化への対応 	<ul style="list-style-type: none"> GHG第三者検証取得（対象拡大） 欧州CSR対応の準備開始 法規制情報の継続収集 	

ESGの各施策も着実に進めています。
企業価値の更なる向上に向け、各施策の取り組みを進めました。

人材戦略～新成長戦略に基づく人財投資の基本方針の進捗

① 成長事業への人財シフト

即戦力人財を中心に
半導体アドバンスドパッケージ事業への
人的リソースのシフトが進展
人員増強による成長基盤確立を目指す

EUV事業の開発投資を一部中止
LS、PHS事業の投資案件を絞り込み抑制
→ 適正リソースへ見直し実施

人財
適所適材へ再配置

デジタルリソグラフィ装置
次世代露光装置 等

② 成長戦略を支える人材育成

2025年4月にリスキリング支援専門部署を新設
事業ポートフォリオ変革による人財の再配置を
促進するためのリスキリングを支援

人財

受入

新設 キャリア支援センター

再配置

IP事業

③ セカンドライフ支援制度の拡充・特別募集

「事業ポートフォリオ変革」と
「事業の着実な成長」の実現に向け、
組織人員の最適化による経営効率を改善を図る

特別募集の概要

対象	一定条件を満たした従業員
募集期間	2025年3月～6月末
優遇措置	特別退職一時金の付与、再就職支援
損益影響	2025年3月期及び2026年3月期決算に計上予定

特損計上：FY24_約14億円、FY25_未定

固定費削減効果：約22億円*

*対FY24のFY26効果

人財戦略も、成長事業への人財シフトの方針のもと、リスキリングと人材育成の取り組みを進めました。

また、セカンドライフ支援制度の拡充による経営効率の改善を進めております。

事業戦略×財務戦略×ESGを同時に推進することで、目指す姿を実現

FY25~26

現状

FY23	FY24
ROE 4.5%	ROE 3.1%

事業戦略



財務戦略



ESG

- **成長戦略**
半導体ADP事業 → 関連装置の営業利益 **+102億円**
IP事業の成長拡大 → FY26_営業利益率 **14%以上**
- **事業ポートフォリオ変革**
構造改革 → **73億円以上**の固定費削減
- 自己資本圧縮 → FY26末：**1,800~1,900億円**へ
- 株主還元強化 → 自社株投資 **200~300億円**実施
→ 下限配当 **70円**継続
- バランスシートの見直し → 有価証券の縮減 **▲189億円**
(FY24~FY26トータル：▲350億円)
- 人財戦略 (注力事業への人材シフト&人件費コントロール)
- エンゲージメントスコア向上

目指す姿

FY26	FY30
ROE 8%以上	ROE 12%以上

まとめますと、現在、成長戦略及び構造改革を同時に進めている「事業戦略」、そして、「財務戦略」及び「ESG」と3つの戦略を同時に推進することで、目指す姿であるPhase IでのROE 8%以上、Phase IIのROE12%以上の実現を着実に進めてまいります。

(スライド28ページへ)

Appendix

次世代半導体パッケージ技術のロードマップ

生成AI半導体の台頭による次世代半導体パッケージ技術の変化（トレンド）

生成AI半導体需要の増加

前工程の微細化限界によるチップレット技術の台頭（目的：コスト改善等）

チップレット技術の台頭

インターポージャー基板の需要拡大・大型化（目的：半導体の性能向上等）

インターポージャー基板の最新トレンド

大型化→パネル化
（目的：生産効率向上等）シリコンインターポージャーから有機への置き換え
（目的：コスト削減、高速大容量データ処理能力等）技術ロードマップ
推進上の課題

- 有機材使用や大型化に伴う基板の歪みによる影響への対応（歩留まり改善）
- コスト低減

最後に、半導体アドバンスドパッケージ事業について、補足させていただきます。

半導体アドバンスドパッケージ分野では、需要が拡大するとともに、技術トレンド変化が生じており、大きなビジネス機会ととらえています。

生成AI半導体の台頭に起因し、次世代半導体パッケージにおいて、チップレット技術が台頭してきました。

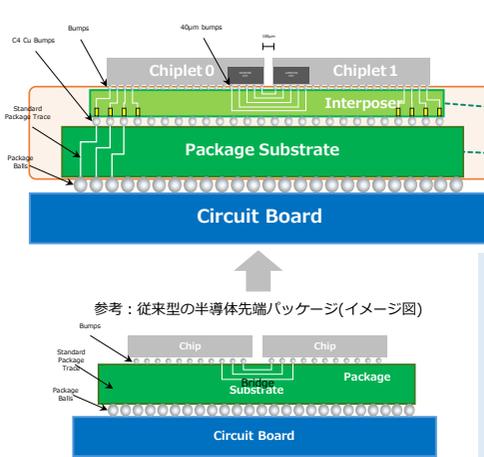
これにより、インターポージャー基板を中心に更なる技術革新が進むと見えています。

一方、これらの技術ロードマップの進展には課題も多く存在すると認識しており、この課題解決にウシオの露光装置が貢献できると考えています。

次世代半導体パッケージ（生成AI）とウシオの製品ラインナップ

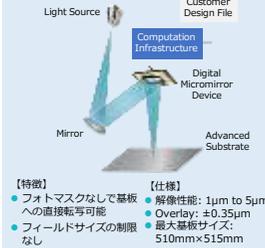


生成AIに求められる最先端パッケージ構造(イメージ図)

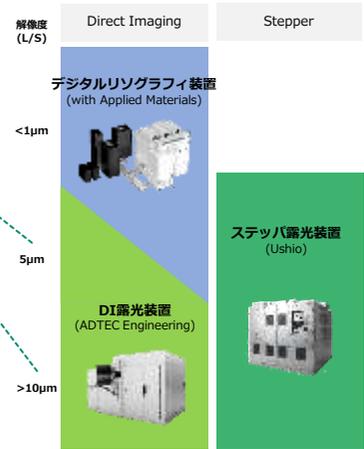


	求められる解像度 (L/S)	今後の技術トレンド
前工程	数nm	チップレット化
後工程	サブµ~2µm	有機化、大判化 パネル化
	5~10µm	ガラスコシ化 高解像度
	30~100µm	

デジタルリソグラフィ装置(イメージ図)



ウシオの露光装置ラインナップ



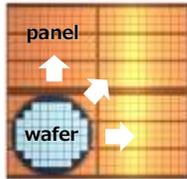
生成AI半導体の台頭による次世代半導体パッケージ基板とウシオの露光装置のラインナップを整理すると、記載のイメージとなります。

今回、アプライドマテリアルズ社との業務提携によるデジタルリソグラフィ装置が加わることで、次世代半導体パッケージ基板の進化及び需要拡大に着実にミートした製品を提供する体制が整うこととなります。

DLT装置の主な特徴

DLT装置は、高い露光性能と優れたデジタル機能を備えたマスクレス装置。ステッパと同等の解像力・重ね合わせ精度、量産に適したスループットを実現。基板サイズ・材料への柔軟性を有し、優れた量産性と迅速な試作開発能力を兼ね備えた装置

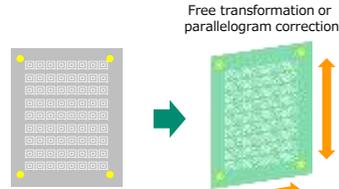
インターポザー基板の
大型化・大判化への対応



ウエハに対しパネル化により、チップの取れ高が拡大
=> 後工程パッケージのコストを大幅に低減

DLT装置（特徴）
量産に適したスループットの実現とフィールドサイズの制限のないマスクレスにより高いチップの取れ高を実現
➡ お客様のコスト低減に貢献

チップレット化及び基板の有機化による歪みで生じる
ダイシフトへの対応



有機材の伸縮やチップ及びブリッジの搭載時に、ダイシフトが生じ易い
=> 歩留まり悪化の要因

DLT装置（特徴）
マスクレス及びDDC*機能により、基板の歪みやダイのスレに対する補正能力の高い露光が可能
➡ お客様の歩留まり改善に貢献

*DDC: Dynamic Digital Connectionの略

次世代半導体パッケージ技術の進化における課題を改善し、お客様の歩留まりとコストに貢献する装置

デジタルリソグラフィ装置の主な特徴を改めてご説明します。
デジタルリソグラフィ装置は、高い露光性能と優れたデジタル機能を備えたマスクレス装置で、ステッパと同等の解像力・重ね合わせ精度、量産に適したスループットを実現するとともに、基板サイズ・材料への柔軟性を有し、優れた量産性と迅速な試作開発能力を兼ね備えた装置です。
次世代パッケージ技術の進展において抱えている課題。例えば、大判化への対応やチップレット化などによるダイシフトに適した機能を有し、お客様の歩留まりやコスト低減に貢献する装置です。
是非、ご期待ください。

以上で、私からの説明を終わります。

セグメント別係数予想（参考値）

FY26は、既存の露光装置が当初予定を下回り推移するも、事業ポートフォリオ変革（事業の取捨選択）が進み、計画以上の効果（収益性が改善）を想定 セグメント係数（参考値）の一部を見直すも、方向性に変更なし

セグメント	Phase I 単位：億円								
	FY2024実績			FY2025計画			FY2026（参考値）		
	売上高	営業利益	営業利益率	売上高	営業利益	営業利益率	売上高	営業利益	営業利益率
	下線部分のみ見直し								
IP	789	96	12.2%	760	65	8.6%	<u>1,050</u>	<u>150</u>	14%
VI	808	7	0.9%	760	45	5.9%	700	55	8%
LS	61	▲10	▲17.7%	60	▲6	▲10.0%	70	▲5	▲7%
PHS	103	▲4	▲4.0%	105	▲4	▲3.8%	120	3	3%
連結合計*	1,776	88	5.0%	1,700	100	5.9%	1,950	200	10%

FY2030
目指したい姿

変更なし

(参考値)

営業利益率：12%以上
(売上高：2,000~2,500億円)

↑

IP事業を柱とした事業ポートフォリオへ
(IP事業：営業利益率18~20%を目指す)

+

新規事業（LS事業を含む）を育成

+

VI・PHSは安定したキャッシュを生み出す事業へ
(将来的に営業利益率12%以上を目指す)

* 連結合計には「その他」セグメントも含む

売上高総利益率及び販管費率 推移

収益構造改善の取り組みを継続し、売上総利益率は向上。販管比率は抑制。筋肉質な体質へ改善を進める



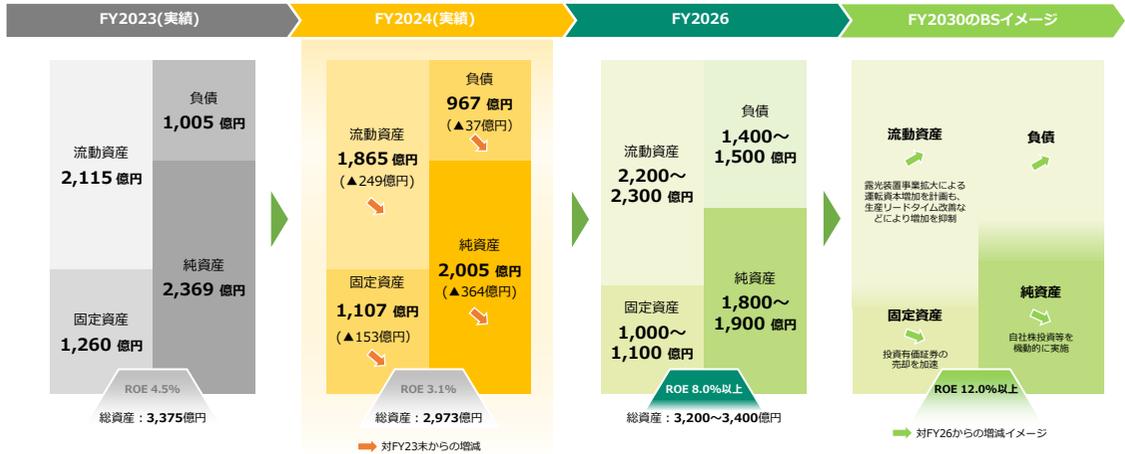
資本効率・バランスシートの見直し

半導体市況の低迷による売上高利益率及び総資産回転率が悪化も想定範囲内で推移。財務レバレッジは改善

	FY2023(実績)	FY2024(実績)	FY2026(計画)	ROE向上実現に向けた施策
ROE	4.5 %	3.1 %	8 %以上	FY2030 : 12 %以上
			変更なし	変更なし
売上高純利益率 当期純利益÷売上高	6.0 %	3.8 %	約 8 %	<ul style="list-style-type: none"> ● ポートフォリオ変革を踏まえた新成長戦略の各施策を着実に実施することで売上高純利益率を向上 ● 半導体アドバンスドパッケージ事業の拡大による運転資本の増加を計画も、露光装置中心とした生産リードタイム改善などにより資産圧縮を進める ● 有価証券の売却加速により金融資産を事業資産/株主還元へ振替 ● Phase I : 資本最適化*のため自社株投資拡大や下限配当設定による株主還元を拡大 (*自己資本は2,000億円以下を維持) ● Phase II : 機動的な自社株投資を計画 ● 財務レバレッジ向上のため有利子負債を活用
総資産回転率 売上高÷総資産	0.53 回	0.56 回	約 0.6 回	
財務レバレッジ 総資産÷自己資本	1.42 倍	1.45 倍	約 1.7 倍	

資本効率・バランスシートの見直し

FY24は、自社株投資や有価証券の売却により純資産及び固定資産ともに計画通り圧縮が進み、資産効率が改善傾向
BSマネジメント方針



キャッシュアロケーション

FY24のキャッシュアロケーションは概ね計画通りに推移。FY24~26の累積計画に変更なし



Glossary (用語集)



IP事業	IP	Industrial Process	IP事業	インターポーザー	貫通電極による表裏の回路の導通をとり複数のチップ同士をつなぐ基板	
	ADP	アドバンスドパッケージの略		エキシマ	エキシマランプ (Excimer lamp) 及びそれを搭載したユニット・装置	
	Bridge (ブリッジ)	複数のチップ同士を接続する方法の1つ		サーマルプロセス	ウエハを高温で加熱する半導体製造工程	
	DDC	Dynamic Digital Connection : ダイシフトやローテーションに対して、位置合わせ精度を向上させる機能		ステップ	ステップアンドリピート (step and repeat) 方式で露光を行う投影露光装置	
	DI	Direct Imaging : マスクを使わず、直接描画する露光方式		ダイシフト	パネル上に配置されたチップが設計上の位置からずれる現象	
	DI露光装置	DI方式による露光装置		半導体アドバンスドパッケージ	チップレットをはじめとする半導体の2xD、3D化に対応する最先端のパッケージ分野	
	DLT	Digital Lithography Technology : デジタルリソグラフィ技術		VI	Visual Imaging	
	DLT装置	デジタルリソグラフィ装置のこと。アプライドマテリアル社との業務提携によるDLT(デジタルリソグラフィ技術)搭載のDI露光装置		AVシステムコンサルティング事業	海外子会社で展開している「Nationwide 360 Audio Visual Services」のこと	
	EUV	Extreme Ultraviolet Radiation : 極端紫外放射 (極紫外放射)		LS事業	LS	Life Science
	LCD	Liquid Crystal Display : 液晶ディスプレイ		PHS事業	PHS	Photonics Solution

<免責事項>

本資料で記述されている将来の当社業績に関する見通しは、現時点で入手可能な情報を基に当社が判断した予想です。従いまして、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

<本資料に関するお問い合わせ先>

ウシオ電機株式会社

IR室

(03) 5657-1007

ir@ushio.co.jp

<http://www.ushio.co.jp/jp/ir>